

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 1 月 14 日(14.01.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/006301 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 18/24 (2006.01) *C23C 18/30* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/062485
- (22) 国際出願日: 2015 年 4 月 24 日(24.04.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-142468 2014 年 7 月 10 日(10.07.2014) JP
- (71) 出願人: 奥野製薬工業株式会社(OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町 4 丁目 7 番 10 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 永峯 伸吾 (NAGAMINE, Shingo); 〒5380044 大阪府大阪市鶴見区放出東 1 丁目 10 番 25 号 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所内 Osaka (JP). 北 晃治 (KITA, Koji); 〒5380044 大阪府大阪市鶴見区放出東 1 丁目 10 番 25 号 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所内 Osaka (JP). 大塚 邦顕 (OTSUKA, Kuniaki); 〒5380044 大阪府大阪市鶴見区放出東 1 丁目 10 番 25 号 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人三枝国際特許事務所(SAE-GUSA & PARTNERS); 〒5410045 大阪府大阪市

中央区道修町 1-7-1 北浜 T N K ビル Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN PLATING METHOD

(54) 発明の名称: 樹脂めっき方法

(57) Abstract: Provided is a resin plating method that uses an etching bath having manganese as the active ingredient, and that can stably maintain etching performance even during sustained use. The resin plating method includes an etching step, which has an article containing a resin material as a processing subject and uses an acidic etching bath containing manganese, and a catalyst imparting step, which uses palladium as a catalyst metal, and the resin plating method is characterized by further containing a step for maintaining the palladium concentration in the acidic etching bath at no greater than 100 mg/L.

(57) 要約: マンガンを有効成分とするエッチング浴を用いる樹脂めっき方法において、連続使用時においても安定したエッチング性能を維持することが可能な方法を提供する。樹脂材料を含む物品を被処理物として用い、マンガンを含む酸性エッチング浴によるエッチング工程、触媒金属としてパラジウムを用いる触媒付与工程、及び無電解めっき工程を含む樹脂めっき方法において、該酸性エッチング浴中のパラジウム濃度を 100 mg/L 以下に維持する工程を更に含むことを特徴とする樹脂めっき方法。



WO 2016/006301 A1